

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-05-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	通过价值在线（www.ir-online.cn）以网络远程方式参与公司2023年度网上业绩说明会的广大投资者。
时间	2024年5月16日（星期四）14:00-16:00
地点	网络远程方式，价值在线（www.ir-online.cn）网络互动
上市公司接待人姓名	董事长/总经理 徐一俊 独立董事 郑东海 副总经理/董事会秘书 李志萍 财务负责人 黄朝财
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>浙江中晶科技股份有限公司（股票代码：中晶科技003026.SZ）是一家专业从事半导体单晶硅材料及其制品研发、生产和销售的国家高新技术企业，是全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，公司拥有宁夏中晶、西安中晶、中晶新材料全资子公司及江苏皋鑫控股子公司。</p> <p>公司拥有先进的具备自主知识产权的核心技术和工艺，配备优良的生产、检测设备和管理系统，以国际一流半导体企业为标准，致力于高品质半导体单晶硅材料及其制品的研发和生产。公司在半导体用单晶硅棒、研磨硅片、高压整流器件三个细分产业具有市场领先地位，形成以研磨硅片、抛光硅片、芯片元件为核心业务的三大产业板块，积极成为世界先进的半导体硅材料制造商而努力奋斗。</p>

二、互动交流

1、想了解一下江苏皋鑫电子有限公司目前的建设进度，预计预计投产时间。

您好！2023年8月，江苏皋鑫《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》正式开工，当前处于项目建设阶段，公司将持续加大研发投入和新产品导入，积极推动项目建设投产。谢谢。

2、23年亏损这么多24年有什么计划

您好！影响2023年度业绩变动的主要原因有：（1）募投项目正处于爬坡上量阶段，产品成本较高，各项经营费用增加。（2）公司基于谨慎性原则对存货等资产进行减值测试，导致资产减值损失增加。（3）公司受下游客户需求下降影响，产能利用率不足，产品整体毛利率同比有所下降。公司将通过不断加大技术研发投入，开发新产品、积极开拓市场，缩短募投项目量产爬坡时间、推进工艺技术不断提升，提高自动化水平，降低成本等方面来提升公司业绩。谢谢。

3、怎么看不到画面

您好！2023年度网上业绩说明会以文字交流形式问答形式与投资者进行互动，无直播画面，谢谢。

4、公司当前各业务发展情况如何？

您好！公司主营业务为半导体硅材料及其产品的研发、生产和销售。公司当前主营业务的经营布局如下：半导体硅单晶生长及晶棒加工以宁夏中晶为主要生产基地；半导体单晶硅片加工以浙江中晶与西安中晶为核心，该业务在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位；募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用

单晶硅片项目》以中晶新材料为实施主体，抛光硅片产品将会成为公司未来重要主营产品之一，当前处于增产上量和新客户认证过程中；江苏皋鑫在现有高频高压半导体芯片及器件产品基础上，《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》目前处于项目建设阶段，未来将进一步扩大产能、研发新品、丰富产品类型。谢谢。

5、公司一季度的业绩情况好转，请问公司近期会有哪些利好信息公布？

您好！公司会按照信息披露相关规定履行信息披露义务，请您持续关注公司公告内容。谢谢。

6、江苏皋鑫产品应用领域有哪些方面？

您好！江苏皋鑫生产的半导体功率芯片及器件主要作为各类电子设备的关键零部件，广泛应用于微波炉、激光打印机、复印机、CRT/TV 显示器、X 光机及大型医疗设备等领域，在高压整流器件细分领域具有市场领先地位。谢谢。

7、怎么没人？

您好！公司业绩说明会的时间为 5 月 16 日 14: 00 至 16: 00，会议期间公司在线回复投资者问题，感谢关注。

8、介绍 23 年经营情况呀

您好！2023 年营业收入 34,849.53 万元，同比增长 3.06%，归母净利润-3,406.57 万元，同比下降 275.55%，扣非后净利润-3,705.36 万元，同比下降 311.00%。2024 年一季度营业收入 10,651.24 万元，同比增长 37.64%，归母净利润 122.74 万元，同比增长 117.29%，扣非后净利润 59.84 万元，同比增长 108.01%。谢谢。

9、撒都看不到，还直播

您好！2023 年度网上业绩说明会以文字交流形式问答形式与投资者进行互动，无直播画面，谢谢。

10、面对当前的公司股价，在市值管理方面，公司有没有一些计划？

您好！公司一方面加大募投项目客户开发进度，提升良率和交付能力以减少项目投产导致的亏损；另一方面，继续加强公司研磨片业务以及功率芯片与器件业务接单交付，提高营收规模和利润水平。同时，股份回购工作也在进行中。谢谢。

11、针对上市以来股价不断下跌的情形，贵司是否有什么解释或措施？

您好！公司一直关注并高度重视公司市值情况，在创造良好业绩的同时真诚回报股东。公司将在做好经营发展创造良好投资价值的基础上进一步加强与外部的沟通交流，向市场传递公司价值。谢谢。

12、公司目前的回购进度如何？

您好！公司股份回购计划在持续实施，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司在回购期间，于每个月的前 3 个交易日内披露回购进展情况。截至 2024 年 4 月 30 日，公司累计回购 230,000 股，成交总金额为 4,989,205.00 元(不含交易费用)。谢谢。

13、24 年一季度业绩同比、环比大幅增长是如何实现的？

您好！公司一季度业绩同比上升的原因主要是：（1）公司重视各业务拓展工作，提升交付能力来满足客户需求。

（2）公司重视产品质量，保障产品品质，进一步提升市场竞争优势。（3）公司持续加大研发投入，优化生产工艺、开发新产品。未来，公司将努力做好生产经营工作，提升公司内在价值，以稳健的经营业绩与切实的社会责任担当回报投资者。谢谢。

14、能否说一下，公司在行业中的优势？

您好！公司自成立以来一直专注于半导体单晶硅材料及其制品的研发、生产和销售，具有完整的生产供应链，凭借长期积累的技术优势、产能优势、质量优势，公司已在国内分立器件用单晶硅棒、研磨硅片以及半导体功率芯片及器件领域占据领先的市场地位。公司根据下游客户对产品的性能参数、规格尺寸等方面的要求进行定制化生产，稳定的产品品质、可靠的生产能力获得下游客户的广泛认可。未来公司将在巩固现有行业地位的前提下，加快推进募投项目增产上量、芯片项目建设发展，进一步完善产品结构，提升公司创新能力和核心竞争力。谢谢。

15、超大规模集成电路用单晶硅片有哪些新客户正在认证？

您好！目前公司已陆续通过多家客户的产品认证，通过产品认证有集成电路用抛光硅片用户、功率器件用抛光硅片用户，产量爬坡还需要时间。谢谢。

16、请问公司目前有多少研发人员，公司在技术研发上的投入是多少？

您好！截至 2023 年末，公司研发人员 112 人。2023 年度研发费用为 2,633.01 万元，同比增长 31.71%。公司始终

秉持创新驱动发展的理念，持续加大研发投入，始终致力于高品质半导体单晶硅材料及其制品的研发和生产。经过多年的自主研发和技术积累，掌握了多项半导体硅材料制造核心技术，凭借自身扎实的技术实力以及管理能力，以及持续的研发投入，为公司开发新产品新技术、提升行业战略地位提供了充足的物质与技术基础。谢谢。

17、独立董事如何对公司进行监督？

您好！作为独立董事日常密切关注公司的经营情况和财务状况，利用召开股东大会、董事会时间，或者专门安排时间，通过查阅资料并与公司高管交流，到公司现场深入了解公司的经营情况。同时，通过召开独立董事专门会议进行有关事项的审议、积极参与董事会决策、听取公司管理层工作汇报、审查关联交易、与审计机构沟通以及对公司财务报告的真实、准确、及时、完整进行监督等方式，对公司进行有效监管。谢谢。

18、2023 年度公司递延收益增长的原因是什么？

您好！递延收益比年初增加 103.79%，主要原因为报告期内子公司收到与资产相关的政府补助所致。谢谢。

19、公司如何切实履行企业社会责任？公司未来利润增长点主要集中在哪些业务？

您好！公司始终严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构，形成健全的公司管理机制。规范信息披露制度，切实履行社会责任，树立并维护良好的企业形象。公司主营业务为半导体硅材料及其制品的研发、生产和销售。主要产品有半导体研磨硅片、功率芯片及

器件、集成电路用抛光硅片。未来，公司将持续推进新产品和新市场的开拓，以技术创新推动公司的稳健发展。谢谢。

20、公司人才管理方面有哪些重要举措？

您好！公司作为高新技术企业，所属行业属于技术密集型，对人才要求较高。一方面，公司不断完善人才体系建设，坚持通过对内人才自主培育与对外引进行业高端人才、专业技术人才相结合的方式，为公司战略规划实现提供充足的人才储备。另一方面，公司已建立较为完善的薪酬福利制度和企业文化，通过实施股票激励计划，吸引和留住优秀人才。同时，公司持续实施人才引进计划，优化关键人才供给保障机制，强化人才培养标准化体系管理，重点跟进高管、中层干部等关键岗位人才梯队建设以保障公司未来发展的需求。谢谢。

21、公司目前的存货情况如何？

您好！截至2024年3月31日，公司存货12,387.80万元，同比下降37.37%，环比下降5.22%。主要是因为报告期内营收同比增长且降低库存所致。谢谢。

22、公司面对行业的周期性变化都有哪些应对措施？

您好！全球半导体行业景气周期与下游终端应用需求以及自身产能库存等因素密切相关，面对行业的周期性变化，一方面公司通过不断提高产品与服务质量，为客户提供更优质的解决方案，持续提升客户满意度，进一步巩固与下游客户的合作关系；另一方面公司积极通过研发创新、开拓新客户等方式进行有效应对，减少周期性变化带来的不利影响。谢谢。

23、公司子公司江苏皋鑫目前的经营及新项目的建设情况如何？

您好!江苏皋鑫原有厂区的生产经营正常开展。2023年8月,江苏皋鑫《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》正式开工,当前处于项目建设阶段。江苏皋鑫拥有国际先进水平的塑封高压二极管制造技术,具有行业领先的产品设计和产品应用技术的研发能力。公司将持续加大研发投入和新产品导入,并积极推动项目建设投产,将江苏皋鑫建设成为优秀的半导体芯片研发和生产基地。随着项目推进,未来企业将迎来新的发展阶段。谢谢。

24、公司的生产经营模式如何？

您好!公司拥有独立的采购、生产和销售体系,主要销售半导体单晶硅棒、半导体单晶硅片及半导体功率芯片及器件产品。(1)采购方面,公司主要采取“以产定购+安全库存”的采购模式。(2)生产方面,公司主要采取“以销定产+自主备货”的生产模式,根据销售订单及市场预测需求安排生产计划。(3)销售方面,公司主要采取“直销为主、分销为辅”的销售模式,产品前期经过送样试用、小批量稳定性论证,到后续的生产现场考核评估和合格供方扩批采购,最终被纳入客户的合格供应商体系,开始量产并销售给客户。谢谢。

25、请问独董如何评价公司在内部治理的成效？

您好!公司始终坚持规范运作,依法合规运行,深入细致地开展治理活动,不断提高公司治理水平,在重大方面保持了有效的内部控制。作为公司独立董事,我们也将持续履行独董职责,督促公司持续提升管理能力。

26、公司目前订单情况如何？

您好！公司目前生产经营正常, 订单稳定, 同时将持续培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户, 加大市场开拓力度, 提高公司市场规模。谢谢。

27、公司的无形资产比去年增长了, 主要是增长在哪里？

您好！公司 2023 年无形资产 7, 548. 35 万元, 同比增长 40. 96%, 主要是由于 2023 年江苏皋鑫半导体芯片项目新厂房建设正式开工, 随着项目建设需要, 购买了江苏皋鑫所在的土地使用权, 从而导致了公司无形资产的增加。谢谢。

28、公司目前产品的交付能力如何？

您好! 公司目前具备较好的生产能力及货物交付能力, 后续公司将结合实际经营情况, 根据市场需求等情况有序规划、统筹安排, 持续推进公司高质量发展。谢谢。

29、公司募投项目目前的产能情况如何

您好! 公司以中晶新材料为实施主体的募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》各项工作进展顺利, 当前处于增产上量和新客户认证过程中。公司将结合实际经营情况, 根据现有产能、市场需求等情况有序规划、统筹安排, 持续推进募投项目的产能释放。谢谢。

30、请问超大规模集成电路用单晶硅片什么时候能盈利！谢谢！

您好！公司募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》各项工作进展顺利, 当前处于增产上量和新客户认证过程中, 盈利还需要时间, 公司会加快持续推进募投项目的产能释放, 争取尽早盈利。谢谢。

	<p>31、二季度跟同期相比经营情况如何</p> <p>您好！二季度当前生产经营情况良好，半导体研磨硅片业务、功率芯片及器件业务需求出现增长，募投项目抛光硅片产线良率明显提升，业务受产品客户认证周期影响，增产上量尚需要时间，预计二季度同比经营情况整体趋势向好，请您持续关注公司公告内容。谢谢。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月16日